

科技部 AR/VR 創新科技產學媒合交流會



一、活動說明：因應南台灣 AR/VR 與 IOT 產業發展，本活動以提升產學雙方共同合作撰寫計畫書能力為目的，活動內容包括科技部產學計畫及 AR/VR 與 IOT 相關專案說明、邀請計畫執行團隊做經驗分享；並提供業界與學界一個雙向交流互動的機會，期藉此提升產學研發實力與大高雄軟體科技產業能量，歡迎有意願申請科技部相關計畫補助的學界及業界報名參加。

二、舉辦日期：106 年 8 月 31 日(週四) 13:10~16:50

三、舉辦地點：集思高軟會議中心 Giant 中庭交誼廳 (高雄市前鎮區復興四路 12 號 A 棟 1F)

四、主辦單位：科技部工程科技推展中心

五、協辦單位：經濟部加工出口區管理處、國立中山大學產發中心

台北市電腦商業同業公會、高雄市電腦商業同業公會

台灣物聯網產業技術協會

六、指導單位：科技部

七、報名時間：即日起至 106 年 8 月 29 日止。

八、聯絡電話：06-2757575轉61201。

九、服務信箱：em61206@email.ncku.edu.tw

十、報名網址：<https://goo.gl/forms/qXpGi8xelK1XxjZn1>

十一、議程：



時間	活動主題	主持人 / 演講人
13:10~13:25	長官致詞	廖婉君司長 (科技部工程司)
	主席致詞與介紹貴賓	鄭國順主任 (科技部工程科技推展中心)
13:25~13:45	產學合作計畫及產學小聯盟說明	科技部產學司
13:45~13:55	AR/VR 及相關專案推動說明	科技部工程司
13:55~15:15	科技部產學合作計畫團隊申請及執行經驗分享 1. 大型多媒體互動娛樂技術研發聯盟 - 張華城主任 (南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系) 2. 應用雲端技術與巨量資料分析於建構資料中心綠能管理平台 - 楊朝棟教授兼電算中心主任 (東海大學資訊工程學系) 3. 高擬真擴增實境互動技術 - 陸元平副教授 (國立臺北科技大學製造科技研究所) 4. 智慧感知與雲端服務產學技術聯盟 - 洪盟峯主任 (國立高雄應用科技大學電子工程系)	
15:15~15:30	中場休息、媒合交流	
15:30~16:50	綜合座談、Q&A	鄭國順主任 (科技部工程科技推展中心) 科技部產學司/工程司 吳大川組長 (經濟部加工出口區管理處)

下頁為集思高軟會議中心交通資訊，請參考



地址： 高雄市前鎮區復興四路12號A棟

電話： 07-2351070

傳真： 07-2351138



捷運&輕軌

高雄捷運：

- 捷運獅甲站R7四號出口，步行10-15分鐘抵達。
- 捷運獅甲站R7二號出口，轉乘紅16接駁公車至軟體園區站。
- 捷運凱旋站R6一號出口，轉乘環狀168東幹線或輕軌至軟體園區站。

輕軌：

- 軟體園區站-直走約1分鐘抵達。



公車

軟體園區站：

- 15、環狀168、紅16(獅甲站→園區)。



開車

中山高：

中正交流道出口→中正路→於中山路左轉→於復興路右轉→即可抵達。

南二高：

接東西向國道十號→中山高交流道出口→(同中山高路線)。



停車資訊

停車場位置：

- 高軟園區南區綜合大樓B1停車場。
- 高軟園區鴻海大樓B3停車場。